

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>线上/电话会议</u>
参与单位名称	前海开源基金、中欧基金、康禧资本、东吴基金、长江养老保险、太平基金、深圳中天汇富基金、闻天基金、凯联资本、泽铭投资、杭州巨子基金、上海古曲基金、上海世诚资管、上海复胜资管、上海正心谷资管、第一创业资管、浙商证券、招商证券、天风证券、国海证券
时间	2024年8月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、AiDC 事业部总经理：高健 董事会秘书：陈国兵 财务总监：范长征 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了民德电子 2024 年半年度财务情况，随后介绍了目前公司主要业务的发展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。</p> <p>公司条码业务近年来保持稳健增长，今年上半年营收和利润均实现两位数以上增加，毛利率也有所提升；同时，因为公司近几年在功率半导体领域投入较大，且属于生产方面的重资产投入，在前期产能较小的情况下，折旧摊销及运营成本较大，公司利润方面承受一定压力，后续随着各家产能的不断提升，以及市场回暖，功率半导体业务也有望步入快速增长期。</p> <p>一、公司财务情况介绍</p> <p>1、公司 2024 年 1-6 月实现营业收入 1.61 亿元，较上年同期 1.83 亿元减少了 2,228 万元，同比下降了 12.16%，主要原因有：</p>

(1) 全资子公司泰博迅睿电子元器件客户结构及代理产品调整，且受电芯价格波动及下游市场需求低迷影响，泰博迅睿收入同比减少了 4,534 万元；

(2) 控股子公司功率半导体设计公司广微集成，受（6 英寸）晶圆代工产能迁移影响，收入同比减少了 854 万元；

(3) 公司条码识别和自动分拣设备业务销售收入同比增加。

2、公司 2024 年 1-6 月实现归属上市公司股东的净利润-770.44 万元，较上年同期减少 2,138.50 万元，同比减少 156.32%，主要原因有：

(1) 参股的 3 家功率半导体生产企业，公司按权益法核算的长期股权投资收益降幅较大，其中：晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克，今年刚开始批量生产，前期产能较小，且固定资产折旧摊销较大，处于亏损状态；硅片原材料生产厂晶睿电子因为硅片价格原因，加上员工股权激励费用影响，上半年利润也为负；3 家企业上半年计入上市公司的投资收益为-2,006 万元，同比下降了 1,547 万元。

(2) 全资子公司泰博迅睿电子元器件客户结构及代理产品调整，且受电芯价格波动及下游市场需求低迷影响，泰博迅睿的收入与毛利率均下滑明显，上半年电池业务相关的存货计提了较大金额的跌价准备，泰博迅睿 2024 年上半年亏损 718 万元，计入上市公司的利润同比减少 525 万元。

(3) 控股设计公司广微集成，（6 英寸）晶圆代工产能迁移至广芯微电子后，2024 年上半年处于产能提升及客户重新验证阶段，销售和利润有所下滑。

(4) 2024 年上半年，公司条码和自动分拣设备业务收入和利润同比均有提升，为公司持续贡献现金流。

二、公司业务发展情况介绍

（一）AiDC 业务进展

公司于去年底将条码识别业务战略升级为 AiDC（Artificial Intelligence & Data Capture，人工智能&数据采集）事业部，基于 Ai+CIS 的机器视觉平台，拓展了更宽的赛道。今年上半年，AiDC 业务持续保持稳健增长，国内和海外业务都实现了两位数增长，利润方面也创近几年新高。

目前，公司将所有条码产品都升级为采用 Ai 处理器方案的新品，主要对标日本的基恩士、美国的康耐视等工业类机器视觉产品，赛道更广阔，且毛利更高。公司上半年新推出的应用于 IVD（体外诊断设备）行业的系列扫码设备推广顺利，经客户测试

验证，产品性能显著优于国内外主要竞品，且成本更具优势，已覆盖数十家国内外 IVD 品牌客户企业。后续，公司将复制在 IVD 市场的开拓经验，在更多行业细分领域探索机器视觉类新产品和市场，与细分市场龙头企业深度合作，共同开发，推出更多具有极致性价比和差异化功能的新产品。

公司 AiDC 业务在今年依然会保持稳定增长，并持续为公司带来正向现金流。

（二）功率半导体业务进展

（1）设计公司广微集成

广微集成上半年主要还是受限于产能迁移影响，MOS 场效应二极管（MFER）以销售库存为主；新的晶圆代工厂广芯微电子，目前处于产能爬坡状态，且切换工厂后，产品都需要经过客户重新验证，因此上半年广微集成的 MFER 销量较少。

广微集成在广芯微电子生产的 MFER 产品，45V-150V 全系列共一百余款型号已全部实现量产，上半年经过小批量产出、内部测试、客户送样验证等阶段，产品已陆续得到客户认可，开始批量出货，并形成稳定收入，目前，广芯微电子生产产品已占到 MFER 销售的一半以上。随着客户验证逐步完成，以及广芯微电子产能的提升，广微集成的销量有望得到快速提升。

广微集成也在不断开发新品，应用于光伏模块电路保护的二极管产品，需求量很大，客户已经在做产品验证；同时，车规级产品方面，在汽车车灯整流器用的二极管等产品，目前也已经在广芯微电子进行试产。

（2）晶圆代工厂广芯微电子

对于晶圆代工厂广芯微电子，现阶段主要关注其产能和营收情况，关注有没有通过优秀客户验证的量产产品。广芯微电子经过半年的量产爬坡，已经量产的产品包括沟槽式肖特基二极管，45-150V 百余款产品全部开始量产，良率已经达到之前代工厂最好时候的良率；高压/特高压 DMOS 系列产品，200-1,500V 产品已经完成验证，技术难度最大的 1,500V 产品开始量产，同时近期也在导入 2,000V 的产品工艺。广芯微电子目前在手订单充足，且在不断增加中，目前核心任务是快速提升产能。

广芯微电子于 2024 年 5 月顺利通过了 IATF16949 汽车行业质量管理体系二阶段审核，获得符合性声明证书，标志着广芯微电子在质量管理方面符合国际标准，达到了汽车行业供应链的要求，广芯微电子已具备车规极芯片产品生产能力，并开始小批量产品试产。

(3) 超薄背道代工厂芯微泰克

芯微泰克主要是面向先进功率器件的超薄背道代工，上半年批量生产以来，有二十多家国内知名的设计公司和晶圆代工厂在芯微泰克完成了验证，并开始批量出货，得到了行业内主流客户的认可。截至 2024 年 7 月底，6 英寸各类功率器件背道工艺上量达到 3,000 片/月；8 英寸 IGBT、SGT、MOSFET 背道工艺上量达到 2,000 片/月。预计到 2024 年底，6 英寸各类功率器件背道工艺量产达到 8,000 片/月；8 英寸 IGBT、SGT、MOSFET 背道工艺量产达到 5,000 片/月；6 英寸重金属工艺量产达到 4,000 片/月。

上半年，芯微泰克顺利通过了 ISO9001:2015 质量管理体系和 ISO 27001:2022 信息安全管理体系双重认证；同时，芯微泰克正在进行 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，预计到明年一季度可获得符合性声明证书，届时可具备车规级功率器件的生产能力。

广芯微电子以晶圆加工正面工艺为主，配备基本的常规背道工艺；芯微泰克将专注于背道工艺，在背道工艺的技术种类、工艺配置、硬件条件等方面都更为专业全面，为功率器件设计公司和晶圆厂客户提供定制化的背面代工服务。后续，广芯微电子和芯微泰克将联合为广大设计公司提供高性能硅基及碳化硅功率半导体器件定制化代工+超薄片制程全套解决方案。

(4) 硅片原材料厂晶睿电子

硅片原材料企业晶睿电子，受半导体市场低迷及外延片行业库存调整等因素影响，自 2023 年以来，晶睿电子外延片价格下降明显，虽销量有所增加，整体仍为亏损状态；自今年二季度以来，随着市场需求逐步恢复，晶睿电子外延片月销量快速提升，一直处于满产状态，预计到年底外延片产能将增长至 30 万片/月，随着外延片需求保持旺盛，价格也触底回转；同时，智能感知应用特种硅片、MEMS 传感器用双抛片、SOI 等高附加值产品也已经逐步批量出货，有望为晶睿电子带来新的增长。

总体来看，2024 年上半年，公司 AiDC 业务保持稳健增长，并持续贡献正向现金流；功率半导体业务，随着各环节产能不断释放，业务也将步入快速增长期。

因此，站在当前时间节点，从经营层面看，公司各业务板块都比之前要好，AiDC 业务和功率半导体业务的战略升级，按照既定目标持续推进；从财务数据层面看，AiDC 业务的营收、利润等关键财务指标持续向好，功率半导体业务的净利润等关键财务指标转正，也将会在核心环节-晶圆代工的产能达到一定规模后逐步体现。

三、问答交流

1、条码业务在国内和海内外市场销售占比，以及毛利率变动情况如何？

答：2024年1-6月公司条码业务保持稳健发展，销售收入同比增长18%，海外市场销售占比约6成，国内市场销售占比约4成。2024年上半年条码业务毛利率较上年同期有所增长，维持较高水平。

2、公司对AiDC事业部的规划和展望？

答：公司于去年底将条码识别业务战略升级为AiDC事业部，公司将依托自身在条码识别领域深厚的技术积累和丰富的行业经验，以Ai+CIS的机器视觉技术平台，为汽车产业、3C、生物医疗检测设备等先进制造业提供条码识读、OCR、器件颜色、尺寸、形状等各种数据采集解决方案的生产性服务。公司的AiDC业务“源于条码识别，精于条码识别，超越条码识别”，将积极拥抱新质生产力，服务高端制造业升级。扩展至机器视觉领域后，目标市场容量进一步扩大有望迎来更高成长。

公司上半年推出了数款应用于IVD（体外诊断设备行业）行业的视觉检测设备新品，在条码识别功能的基础上，添加了一些简单的视觉特征识别功能，并陆续通过国内数家IVD龙头企业的测试验证，开始小批量供应，替换客户目前使用的进口品牌产品，为客户降本的同时，也通过定制化开发服务解决客户痛点需求，实现双方业务长期绑定合作。后续，公司将复制在IVD市场的开拓经验，在更多行业细分领域探索机器视觉类新产品和市场，与细分市场龙头企业深度合作，共同开发，推出更多具有极致性价比和差异化功能的新产品。

3、广芯微电子6英寸和8英寸产品规划产能分别是多少？

答：广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，一期规划年产120万片6英寸硅基晶圆代工产能，并有少量8英寸硅基晶圆代工产能及6英寸碳化硅晶圆代工产能。广芯微电子预计今年底实现6英寸晶圆代工产能上线3万片/月，产出2万/月，2025年底实现产出7万/月的产能。

4、广芯微电子目前是否有充足的订单，其产能爬坡进度是否会受下游市场景气度影响？

答：广芯微电子前期将优先为公司smart IDM生态圈内的设计公司（广微集成、丽隼半导体、熙芯微电子）提供晶圆代工产能保障，上述设计公司在各自领域都已经经过市场验证的特色产品，并均已在广芯微电子投产，广微集成的45V-150V全系

列百余款 MOS 场效应二极管、丽隼半导体的 200-1,500V 高压/超高压/特高压 DMOS 产品已开始批量生产销售，熙芯微电子的高压 BCD 产品目前在进行验证测试，预计近期完成并开始批量试产。广芯微电子目前已收到客户超过 4 万片的采购订单，在手订单充足，上述设计公司的订单需求足以支撑广芯微电子爬坡阶段的产能。此外，广芯微电子已经筛选并确定若干家技术能力优秀的功率器件设计公司作为合作客户。因此，广芯微电子下游客户需求可以支撑起产能，市场景气度不影响其产能爬坡进度。

5、公司碳化硅业务的进展情况？

答：公司在碳化硅器件领域是基于供应链自主可控的战略进行布局，碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。目前，晶睿电子的碳化硅外延片已经完成了几家客户的验证，后续会陆续开始销售出货；晶圆代工厂广芯微电子和超薄片背道代工厂配备了生产碳化硅产品所需的设备；芯片设计公司广微集成、丽隼半导体等 smart IDM 生态圈内企业，均有碳化硅器件产品量产经验，技术储备丰富。

公司坚持以硅基器件为基本盘，来拓展碳化硅器件。现阶段广芯微电子和芯微泰克均在产能爬坡阶段，且广芯微电子生产碳化硅产品和目前已量产的产品部分工序是通用的，两家公司现阶段核心任务是快速提升现有产品产能，后续将根据产能爬坡进度及市场情况，适时启动产线的调试和碳化硅产品的生产。

附件清单（如有）	无
日期	2024-8-29